

## [I~18]

# The Fabrication and Properties of Pb(Zr<sub>x</sub>Ti<sub>1-x</sub>)O<sub>3</sub> Ferroelectric Thin Films on Pt-Ti-SiO<sub>2</sub> Substrate

박재열, 엄우용, 김민영, 장호정, 임성규, 장지근

단국대학교 전자공학과 반도체연구실

높은 유전상수의 PZT 박막을 제작하고, 이를 DRAM 커패시터 재료로 활용하기 위해 Si웨이퍼(p-type,  $\rho = 1 - 10 \Omega \text{ cm}$ , [100])상에 열산화법으로 2000 Å의 SiO<sub>2</sub> 막을 형성하고 그 위에 고주파마그네트론 스퍼터링 방식으로 Pt/Ti (두께; 3000 Å / 400 Å)의 하부전극과 Pb(Zr<sub>0.6</sub>Ti<sub>0.4</sub>)O<sub>3</sub> (두께; 3000 ~ 5000 Å) 박막을 입혔다. 본 연구에서는 PZT 박막의 양호한 perovskite 구조를 얻기 위해, 고순도 Pb(Zr<sub>0.6</sub>Ti<sub>0.4</sub>)O<sub>3</sub> 재료에 PbO를 혼합하여(첨가된 PbO의 mole fraction: 20% & 40%) sputtering target을 제작하였으며, sputtering deposition 후 하부전극(Pt/Ti)과 PZT막의 열처리과정이 PZT 박막의 유전상수와 결정구조에 미치는 영향을 조사하였다.

실험결과, PZT 박막이 완전한 perovskite 결정구조를 갖기 위해서는 Pt-하부전극이 Pt(111) 방향으로 배향성장 되어야하고 박막표면이 평활해야 한다는 사실을 XRD 및 SEM의 관찰과 C-V 측정을 통하여 확인할 수 있었다.